

Manufacturing



Automatic electroless Ni-Au
plating equipment

リジット基板・フレキシブル基板 無電解 Ni-Au めっき

～特徴～

当社の無電解 Ni-Au 自動ラインは、FPC・FR・アルミ・Cu・テフロン基板等の量産実績があります。

FPC 等の薄物、メタル基板等の重量基板であれば搬送キャリア耐荷重 150kg まで大量搬送可能であり、幅広く生産対応しております。

～生産能力～

◎対応製品サイズ

サイズ (MAX) 510×610mm 約 25,000 m²/Month

◎対応めっき仕様

無電解 Ni めっき 1.50～7.00 μm (P 濃度 6.0±1.0%)

無電解 Au めっき 0.03～0.08 μm

- ◆ファインパターン対応の無電解 Ni-P 浴
- ◆プログラムの選択により、素材に合わせた前処理工程を選択できます。
- ◆無電解 Au めっき液は置換タイプ、置換還元タイプの両方に対応できます。
- ◆置換還元タイプの Au めっきを使用することにより、高い半田接合強度を実現しております。

◇無電解 Ni-Au めっき浴は汚染に非常に弱く、量産前に溶出テスト等の実施をお勧めしております。